


株式会社ジェイ・イー・ティ

2024年12月期
第1四半期決算説明資料

2024年5月10日

A detailed, stylized illustration of a blue circuit board with various components, traces, and a central chip, serving as a background for the left side of the slide.

2024年12月期第1四半期 連結決算概要

業績サマリー

韓国メモリーメーカー及び中国ファウンドリ向け洗浄装置立ち上げが2Q以降に集中 そのため1Qは対前期比マイナスの決算に

売上高 2,796百万円	営業利益 56百万円	経常利益 △14百万円	当期純利益 △45百万円
前期比 △51.6%	前期比 △88.3%	前期比 -	前期比 -

- ✓ DRAMについては生成AI向けサーバーやGPUに多くのHBM (High Bandwidth Memory) が使用されたため、DRAM価格は上昇に転じる
- ✓ 中国については一部ファウンドリで設備稼働率停滞、投資減速の傾向も

連結業績

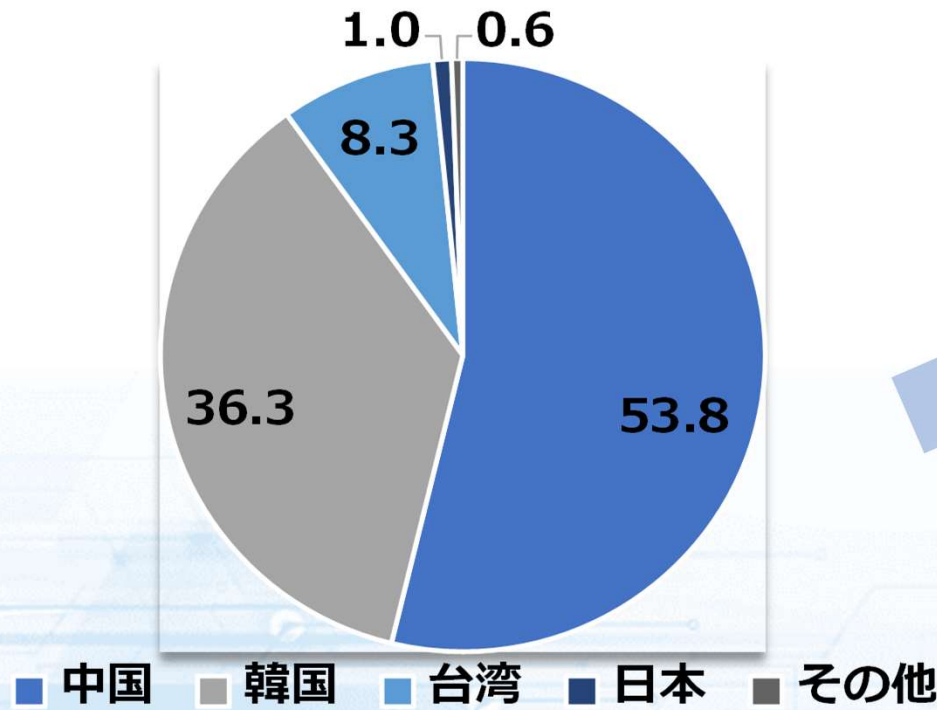
通期予想は据え置き

	2023年1Q			2024年1Q			単位(百万円)	
	売上高	売上比		売上高	売上比	対前期比	通期予想	進捗率(%)
売上高	5,773	—		2,796	—	△51.6%	25,680	10.9%
売上総利益	1,174	20.3%		667	23.9%	△43.2%		
販管費	689	11.9%		610	21.8%	△11.5%		
営業利益	484	8.4%		56	2.0%	△88.3%	2,740	2.0%
経常利益	432	7.5%		△14	—	—	2,600	—
当期純利益	321	5.6%		△45	—	—	1,740	—

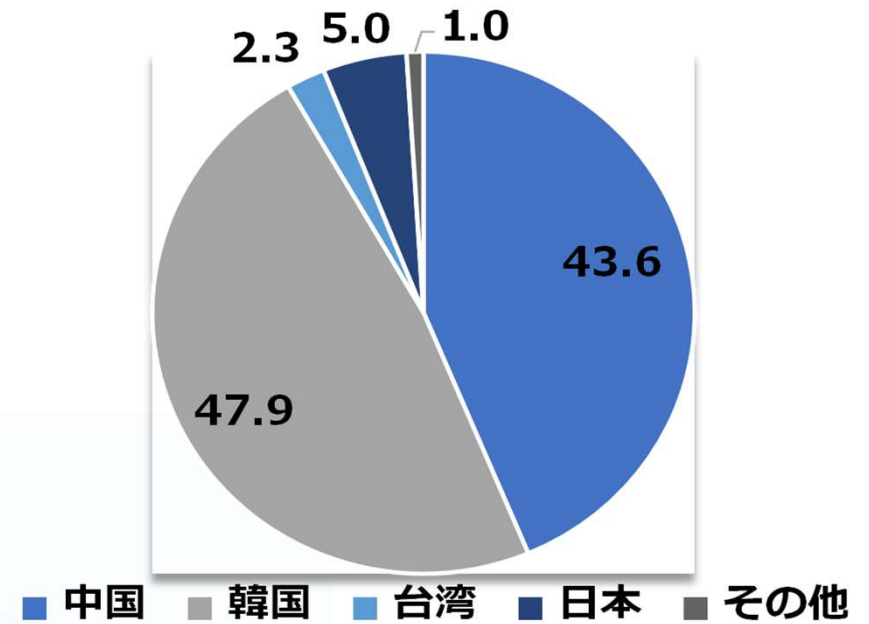
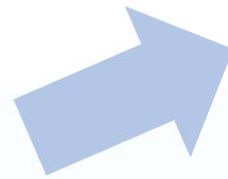
単位未満切り捨て

- ✓ 売上高は前期比51.6%減収、営業利益は88.3%減益
- ✓ 韓国メモリーメーカー向け、中国ファウンドリ向け洗浄装置立ち上げが2Q以降に集中
- ✓ 当1Q期間を利用し、中長期的な成長に向け顧客ニーズに対応した装置の開発や製造に注力

半導体事業 地域別売上高構成比推移



2023年12月期 単位%



2024年12月期 1Q計 単位%

連結貸借対照表

単位（百万円）

	2023年12月期	2024年1Q	増減	主な増減要因
流動資産	27,068	28,863	1,795	「商品及び製品」の増加
有形固定資産	954	938	△16	
無形固定資産	56	69	13	
投資その他資産	695	659	△36	
資産合計	28,774	30,531	1,757	
流動負債	11,496	13,814	2,318	「短期借入金」「前受金」の増加
固定負債	4,866	4,718	△148	
負債合計	16,362	18,532	2,170	
純資産合計	12,411	11,998	△413	配当金の支払いによる 「利益剰余金」の減少
負債純資産合計	28,774	30,531	1,757	

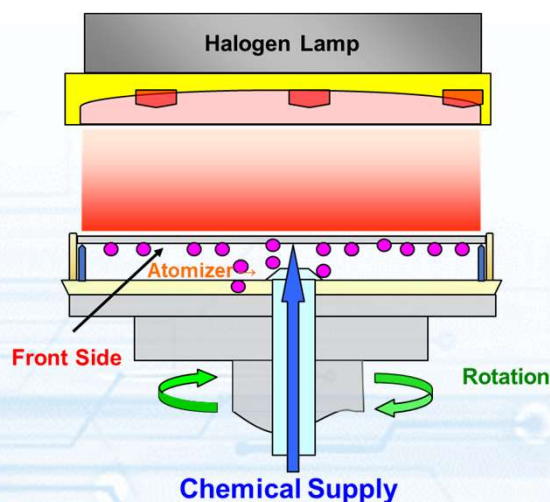
単位未満切り捨て

トピックス Rapidus開発業務受託 試作機フェーズへ

2020年代後半に2nm以下のロジック半導体の開発・量産を目指すRapidus社から
枚葉式半導体洗浄装置の開発業務を受託 → 2023年12月1日リリース

基礎研究開発業務（α機）を完了、試作機（β機） 研究開発業務を受託
→ 2024年4月3日リリース

同社が北海道千歳市に建設中の最先端ロジック半導体製造ライン（2025年4月試作ライン立ち上げ、
2027年量産開始を予定）への当社装置の納入を目指す



新型装置開発のベース HTS300

- ✓ 欧米の利上げやインフレは落ち着きつつあるも、引き続き地政学的なリスクなど不透明要因は多い市場環境
- ✓ DRAM価格は上昇に転じ、NANDフラッシュ価格も底打ち
生成AI向けにデータセンタ投資やPC、スマートフォンでも新たな需要を見込む
- ✓ DRAMの高容量化、NANDフラッシュの高層化等に取り組む
韓国メーカーには米国市場等でのサービス体制の構築、新たな洗浄装置の提案に努める
- ✓ 新たに設立した米国子会社（JET AMERICA INC.）にて、米国市場での新規顧客開拓に着手する
- ✓ 日本市場では最先端プロセスへの対応に加え、車載向けパワー半導体向け等で新規顧客の開拓に努める

通期決算予想

5期連続増収増益の達成を目指す * 推移についてはAppendix参照

単位 (百万円)

	2023年12月期	売上比 (%)	2024年12月期	売上比 (%)	対前期比 (%)
売上高	24,984	—	25,680	—	2.8%
売上総利益	5,535	22.2%			
販管費	2,921	11.7%			
営業利益	2,613	10.5%	2,740	10.7%	4.8%
経常利益	2,444	9.8%	2,600	10.1%	6.3%
当期純利益	1,651	6.6%	1,740	6.8%	5.4%

単位 (百万円)

	2023年12月期 (実績)	2024年12月期 (予定)
設備投資額	41	157
減価償却費	65	76
研究開発費	739	719

* 減価償却費のうち研究開発に伴う費用は研究開発費として記載

今後のビジネス展開の方向性

1. **安定・継続した成長の実現と利益率の改善**
2. **差別化された装置の開発による競争優位の実現**
3. **需要の増減に対応できる生産体制の構築**
4. **北米及び日本での新たな市場開拓**

当面の計数目標

利益率の向上が当面の最優先目標
受注残を消化し、リードタイムの正常化を待って
利益率15%の早期達成を目指す

売上高249億円
営業利益26億円
営業利益率
10.4%
2023年12月期



売上高300億円
営業利益45億円
営業利益率15%

2027年までに達成

2025年までに達成

営業利益率12%

Appendix

リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身
同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、
 販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD. (以下、「ZEUS」) の全額出資のもと、
 2009.4.24に設立、2009.5に**エス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生**

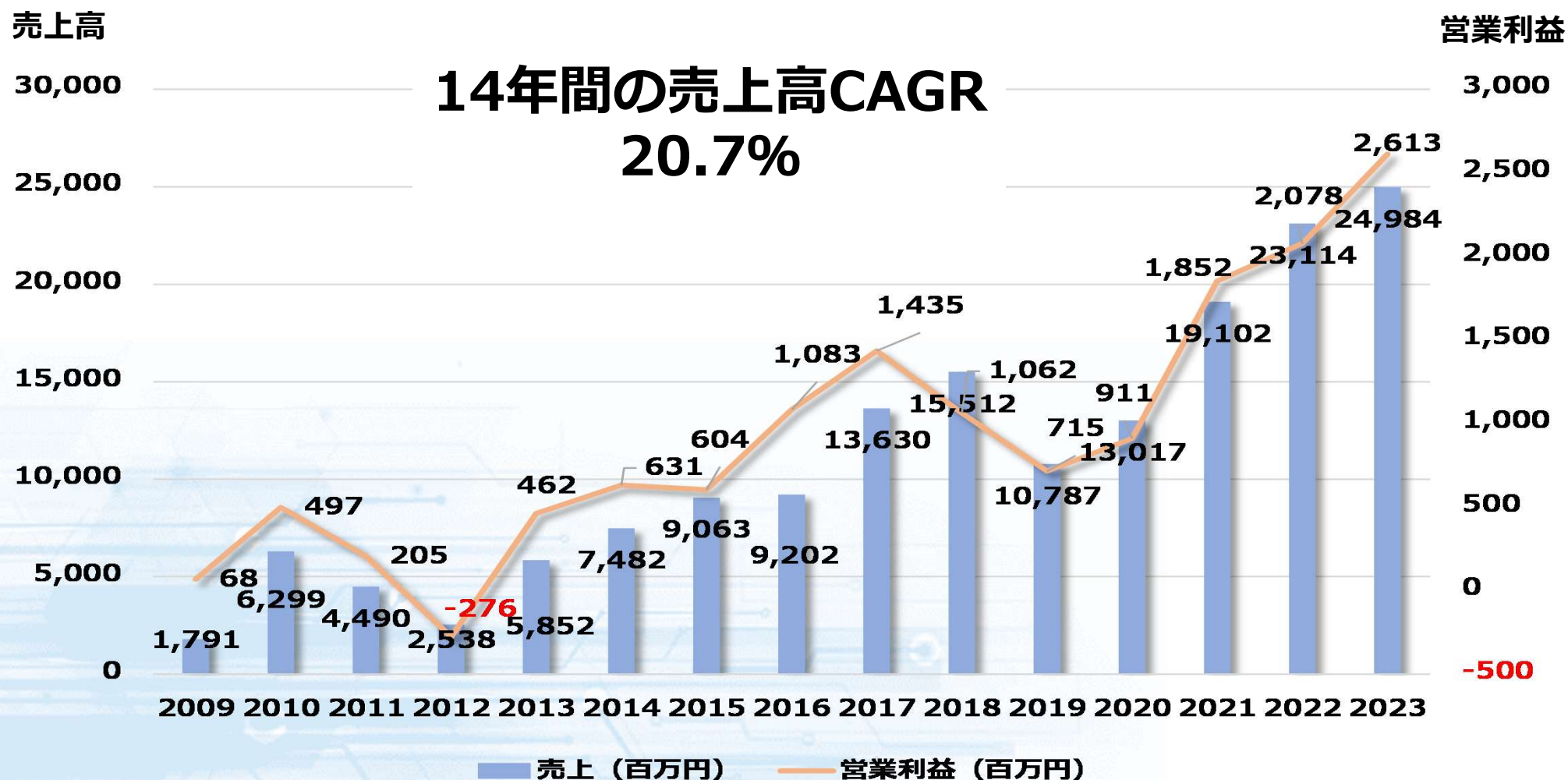
■会社概要

会社名	株式会社ジェイ・イー・ティ
英訳名	J.E.T. Co., LTD.
設立	2009年4月
資本金	1,848百万円 (2023年12月31日時点)
所在地	岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番 TEL 0865-69-4080
代表者	代表取締役社長 房野 正幸
従業員数	165名 289名 ※連結会社含む全従業員数 (2023年12月31日時点)
事業内容	半導体洗浄装置の開発・製造・販売・ アフターサービス等

連結長期業績（売上高・営業利益）推移

シリコンサイクルの影響は受けるものの、**半導体需要の増加に伴い成長**

売上高は2009年17億91百万円から2023年249億84百万円に成長（年平均成長率CAGR20.7%）



* 2019年以前の数字は監査法人による監査を受けていない参考数字

グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



所在地： 大韓民国
京畿道華城市

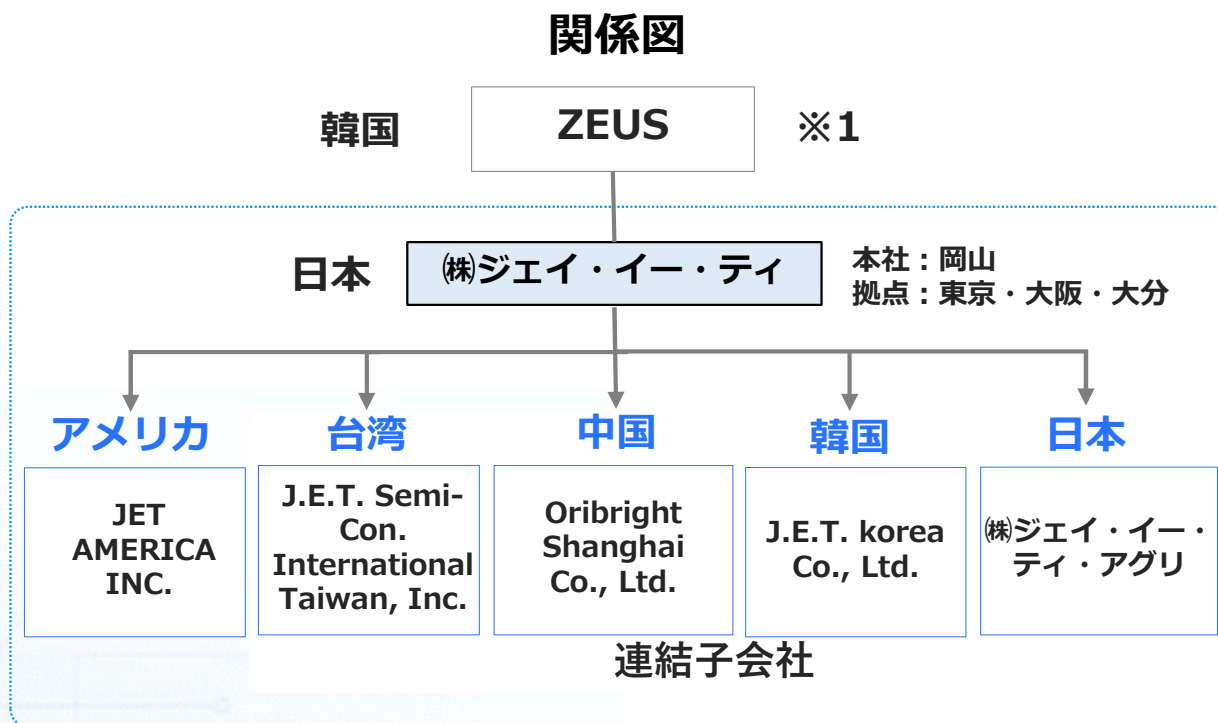
資本金： 5,192百万KRW (2023年12月31日時点)

事業の内容： 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

当社の議決権の保有割合(%)： 66.4% (直接)

関連当事者との関係： 営業取引

取引の内容： 双方より部品・材料等の販売・仕入及び装置製造業務委託、当社よりZEUSへ販売手数料支払い等



※1 韓国取引所KOSDAQに上場

* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

拠点

前身エス・イー・エス(株)時代からのアジア展開を更に**意識的に加速**、
韓国・台湾・中国を中心に拠点網を展開
2023年10月 米国にも拠点設立

■ 国内拠点
 ■ 海外拠点



JET AMERICA INC.

**米国拠点
3名**

**韓国拠点
19名**



J.E.T. Korea Co., Ltd.

- Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所
- Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社

九州出張所(※1)

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※3)

本社 (岡山)



J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
 (HEAD Office) 台湾本社

**台湾拠点
24名**



J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
 (Singapore branch) シンガポール支社

シンガポール 3名

中国拠点 79名

* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略

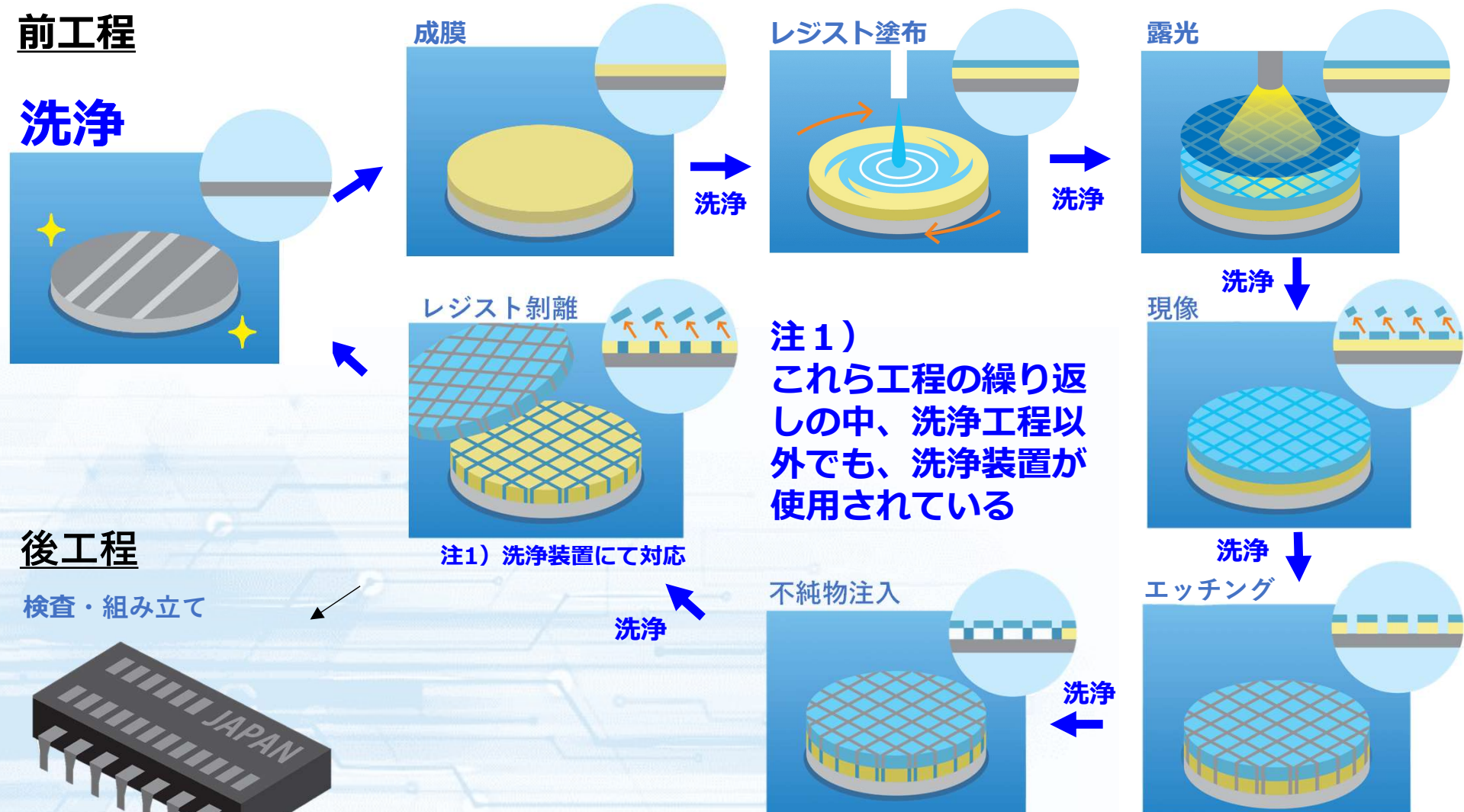
- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供
- ※2 大阪事務所では、LIB製品の営業を推進
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社である(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培

半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

前工程

洗浄



後工程

検査・組み立て

半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社製品の特徴

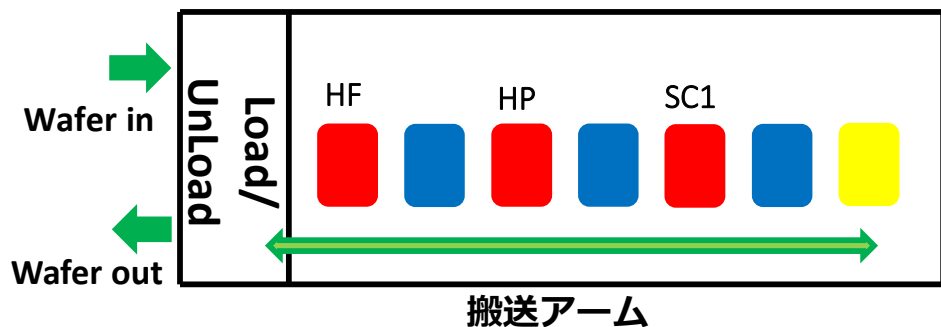
洗浄には薬液を使用するウェット洗浄と酸素ガスやオゾンを用いるドライ洗浄の2種類が存在
より多く使われているのはウェット洗浄。ウェット洗浄にはバッチ式と枚葉式が存在

	バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要	25～50枚のウエハをまとめて各処理槽にて処理する洗浄装置	ウエハを1枚ずつ処理槽内で処理する洗浄装置
長所	生産性が高い	一枚ずつ精密に制御した洗浄が可能
短所	ウエハの塵を拾い易い	生産性が落ちる
現状	一時期、枚葉式に置き換わるも、生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主要洗浄装置
当社製品の特徴	他社の標準化された製品と比較し、カスタマイズ性に優れ、洗浄槽の構成や設置数の変更が可能 F-Typeには唯一当社が対応	赤外線ランプでウエハ上の薬液を高温にするといった特殊な機能を搭載、処理性能を向上させ 使用薬液量も削減 高温・高粘度処理に優位性を持つ

* 当社独自の認識による。

当社バッチ式装置の優位性 → 唯一F-Typeを持つ

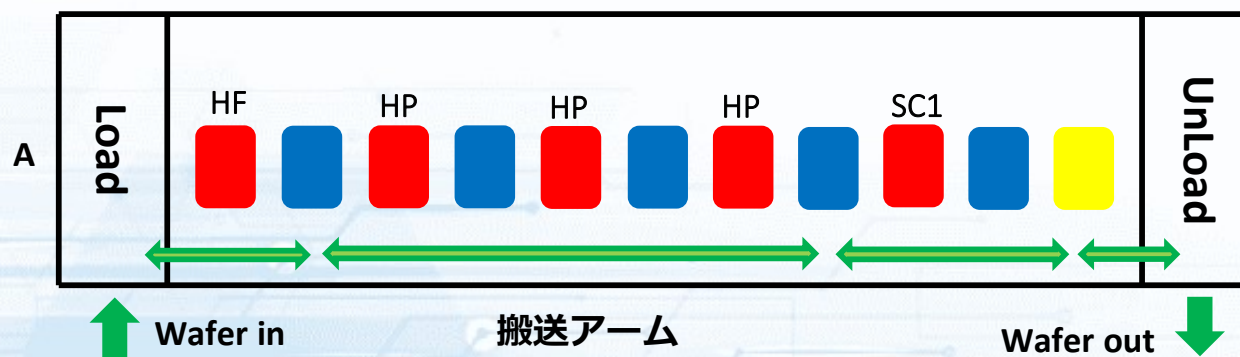
I-Type A社 / B社 / 当社



特徴

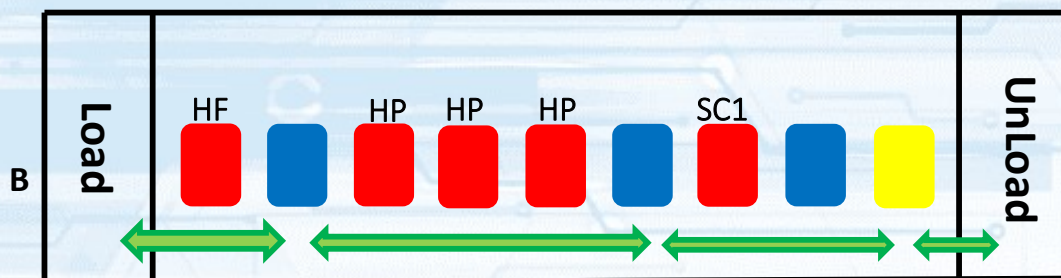
- コンパクト
- 処理槽 MAX 8 槽
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- スループット 最大250w/h

F-Type 当社のみ



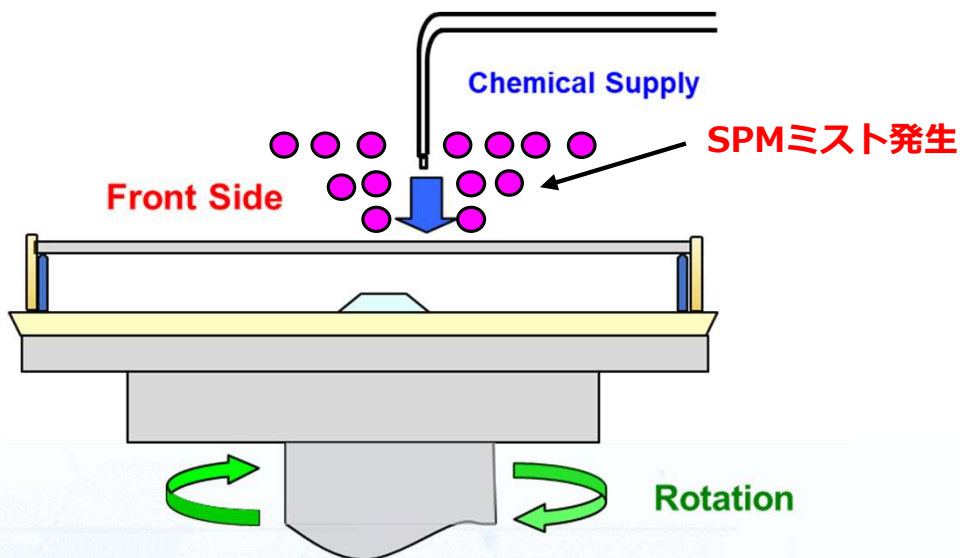
特徴

- 少し大きい
- 処理槽 MAX14槽
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- A/B 選択可能
- Bはケミカル槽を連続配置可能
- 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- **スループット 最大 500w/h**



* 2024年3月時点での当社独自の認識による。

A/B社 枚葉式SPM装置



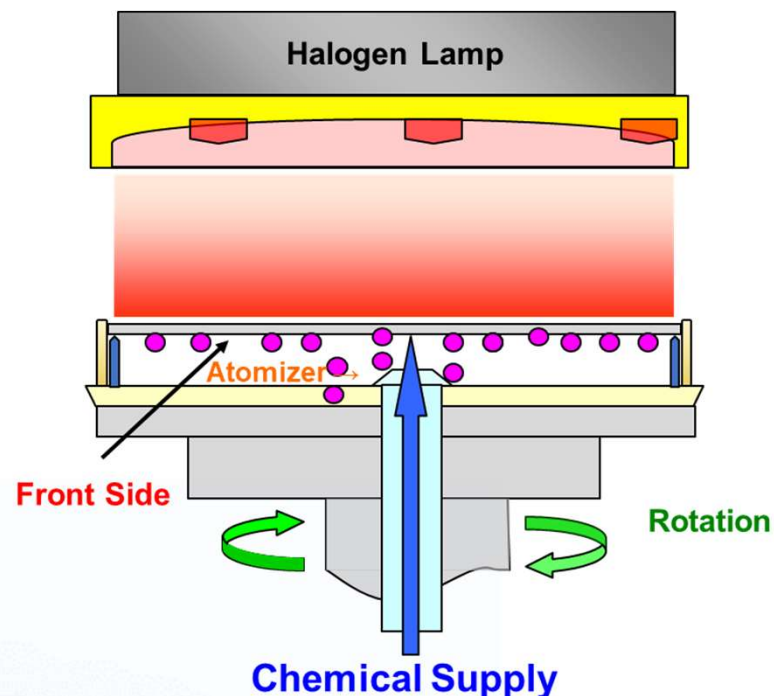
特徴

- 処理温度：150~200℃
- ケミカルの反応熱を利用
 - ➡ケミカルをかけ続けるも、高温維持は難しい
- プロセス時間：5min/HDIレジストウエハ（注）
- ➡必要ケミカル量：3000ml/ウエハ
（5分間ケミカルをかけ続ける必要がある為）
- SPMミストによりパーティクル発生量が多い

* HDIレジストウエハ=硬化層付きのレジストウエハ



* 2023年6月時点での当社独自の認識による。

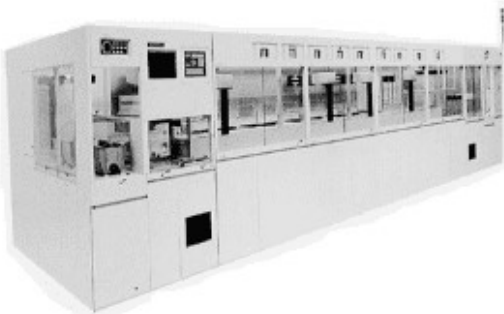

当社 枚葉式SPM装置（HTS-300）



特徴

- 処理温度：200~240℃
- ハロゲンランプにて高温維持可能
- 処理面を反転し、霧状にしたケミカルを使用
- **プロセス時間：0.5min/HDIレジストウエハ**
 - ➡必要ケミカル量：150ml/ウエハ
- SPMミストが拡散せず、パーティクルの発生量が少ない

	BW3000	BW3700
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（洗浄槽の配列、数量を任意に対応可能） ◎生産効率の向上 ◎500WPHに対応する高速LD/ULD ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎二酸化炭素の低減 ◎気体流量のコントロールを実現 ◎標準化仕様化を進め、立上タイム短縮 ◎SEMI standardに対応 ◎EES（EDA or TDI）に対応 	<ul style="list-style-type: none"> ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎排気システムの個別配管により各処理槽の処理能力を安定化 ◎ウエハ間ピッチ7mm処理の実現 ◎ウエハの接触部の縮小化の実現によるパーティクル（微細なゴミ）の発生を減少 ◎気泡発生の低減化を実現 ◎リバースフローシステムにより液置換効率を向上 ◎濃度の安定性を向上 ◎豊富な処理槽種類に対応 ◎1薬液プラス1DIW構成に対応
価格帯 (平均単価) (百万円)	210~400	320~560

	BW2000	HTS-300
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 200mmウエハ対応	枚葉式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 高い生産効率 ◎ 高い洗浄能力 ◎ 省フットプリント ◎ 顧客要求に応えるフレキシブルな構成（処理槽の構成、数量の変更に対応） 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 最小150ccの薬液消費量での処理を実現 ◎ 最高240℃での高温処理を実現 ◎ 最短30秒でのストリップ処理を実現 ◎ ウエハ反転処理によるヒューム（薬液の蒸気）拡散防止の実現
価格帯 (平均単価) (百万円)	150～210	330～540

注意事項

本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2024年5月10日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しの変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ
経営統括本部

TEL 0865-69-4281